

規格改訂情報

ISO 10605 Ed.3 : 2023 ポイント解説

パナソニック ホールディングス株式会社 プロダクト解析センター
Panasonic Holdings Corporation Product Analysis Center

EMCテストラボ 篠山EMCサイト
EMC Test Laboratory Sasayama EMC Site

(免責事項)

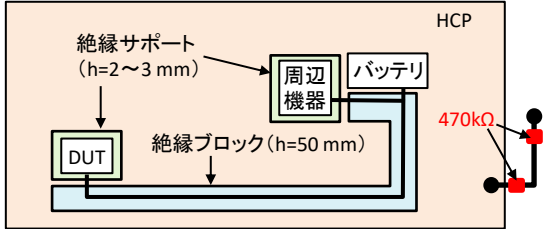
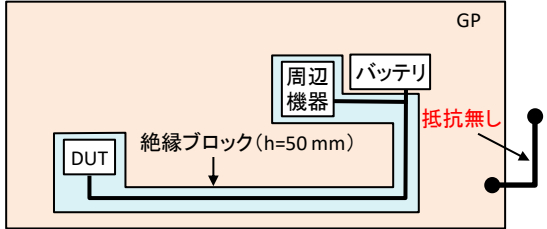
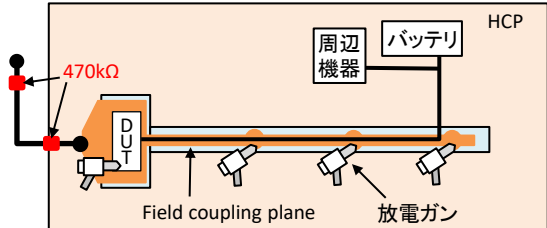
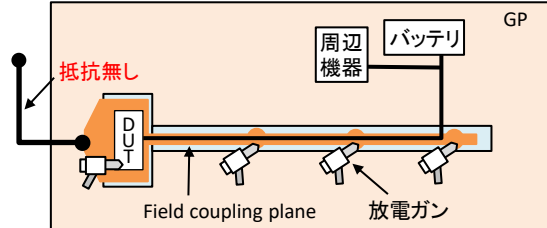
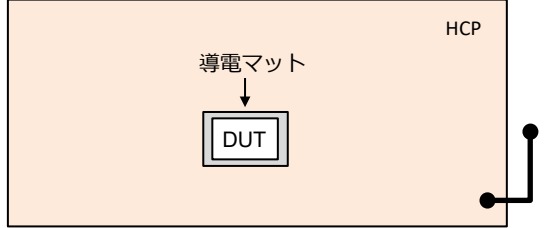
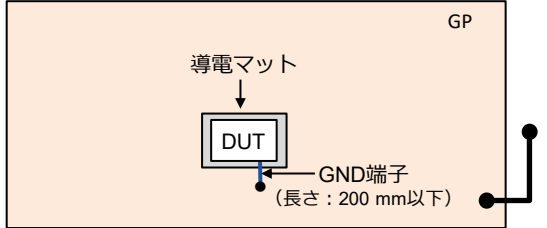
本資料に記載されている内容は、当社の解釈に基づくものであり、公式な見解や公的な規格書を保証するものではありません。公的に発行されている規格書や正式な公文書に関しては、そちらの情報が優先されます。

また、本資料を参考にされた結果、利用者に不利益や損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。資料の内容はあくまで参考情報としてご利用ください。

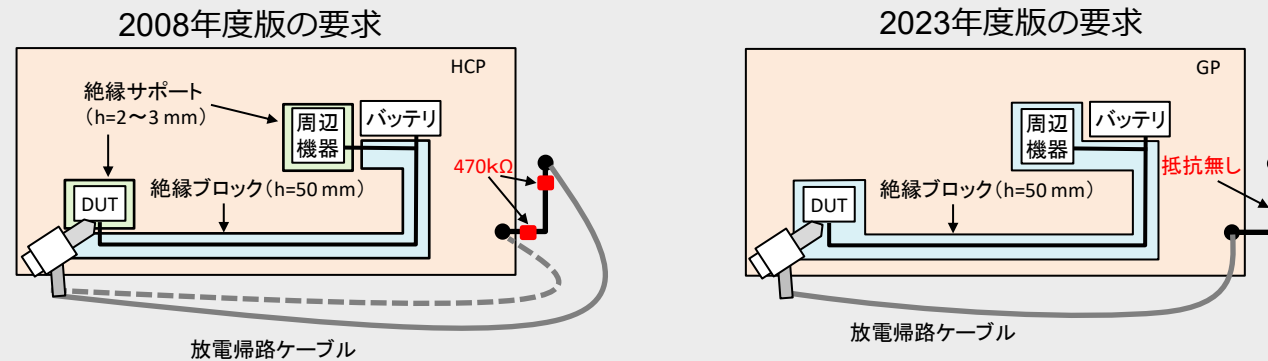
ご理解とご注意のほど、よろしくお願い申し上げます。

主な改訂内容

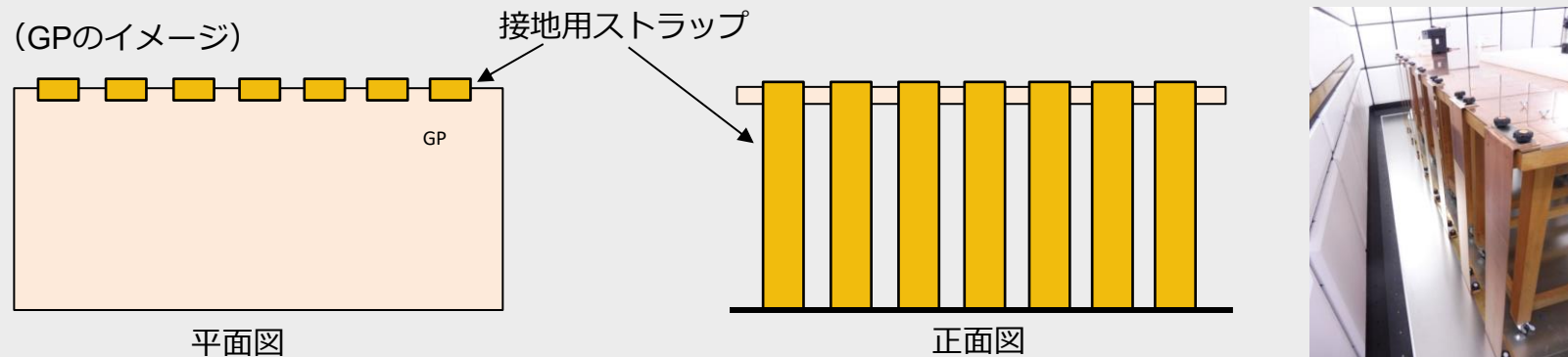
試験結果に影響しそうなところを簡単にまとめました。改訂内容の詳細は規格書をご確認ください。

項目		2008年度版 要求	2023年度版 要求
1	試験条件	25℃±10℃、20%～60% 20℃ 30%の相対湿度が望ましい	25℃±10℃、20%～60% (20℃ 30%の記載が削除)
2	電源ON状態での試験時の グラウンドプレーン(GP)の接地と 絶縁台の高さ ※2023年度版では水平結合板(HCP)の 名称がGPに変更された	470kΩ×2個付のケーブルで接地 - 絶縁サポートとブロックを使用 	- 抵抗無しケーブルで接地 - 絶縁ブロックに統一 (規格書の図はDUTと周辺機器の絶縁台高さが低い) 
3	フィールドカップリングプレーン (Field coupling plane) の試験	Annex Fに記載 	本文 (8.3項 及び 8.4項) に追加 
4	電源OFF状態での試験時の 端子部に対する試験	端子部のGNDはHCPに非接地 	端子部のGNDはGPに接地 

- ・ドラフト段階の途中までは絶縁サポート（insulating support）となっていたようですが、DIS（国際規格原案）時に絶縁ブロック（insulating block）に変更されたようです。
2023年度版の配置図は絶縁サポートのように見えますが、本文は絶縁ブロックに統一されました。
- ・2008年度版は、放電ガンの放電帰路ケーブルの接続箇所が、HCPや床面になっていましたが、2023年度版で、放電帰路ケーブルの接地箇所がGPに統一されたため、抵抗付ケーブルでの接地が不要になりました。



- ・GPの接地は、CISPR25やISO11452シリーズと同様の接地状態に対応できるようになりました（例：床面接地）。



解析の力を、
解決の力に。

Product
Analysis
Center